



平成29年7月31日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード: 3156 東証第一部)
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先: グループ執行役員
経営企画部門長 大澤 剛
(TEL: 03-3491-6575)

(訂正) 「平成27年3月期 第3四半期決算短信 [日本基準] (連結)」の一部訂正について

当社は、平成27年2月6日に開示いたしました「平成27年3月期 第3四半期決算短信 [日本基準] (連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。

1. 訂正内容と理由

平成29年7月31日に公表いたしました「第8期有価証券報告書の提出、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正、並びに平成29年3月期決算短信の提出、過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。

以上

(訂正後)



株式会社 UKCホールディングス

平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



平成27年2月6日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社UKCホールディングス

コード番号 3156 URL <http://www.ukcgroup.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 福寿 幸男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長 (氏名) 田口 雅章 TEL 03-3491-6575

四半期報告書提出予定日 平成27年2月9日 配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無: 有

四半期決算説明会開催の有無: 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第3四半期	182,372	△22.1	4,003	△26.3	4,863	△16.8	3,227	△8.6
26年3月期第3四半期	234,143	8.2	5,432	△8.9	5,847	△1.3	3,532	1.2

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 4,582百万円(△7.7%) 26年3月期第3四半期 4,961百万円(28.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年3月期第3四半期	205.61	-
26年3月期第3四半期	225.00	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期第3四半期	128,289	54,405	42.1	3,442.10
26年3月期	118,436	50,425	42.2	3,186.08

(参考) 自己資本 27年3月期第3四半期 54,033百万円 26年3月期 50,015百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	-	20.00	-	20.00	40.00
27年3月期	-	20.00	-	-	-
27年3月期(予想)	-	-	-	20.00	40.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	300,000	△0.5	7,200	4.0	6,900	△4.7	4,400	0.0	280.28

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：有
- ④ 修正再表示：無

(注) 詳細は、添付資料P. 4「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	27年3月期3Q	15,700,021株	26年3月期	15,700,021株
② 期末自己株式数	27年3月期3Q	2,181株	26年3月期	1,859株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年3月期3Q	15,698,070株	26年3月期3Q	15,698,372株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算説明資料の入手方法について）

四半期決算説明資料は当社ホームページに掲載いたします。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部の経済指標に好調さがみられるものの、消費増税に伴う停滞からの持ち直しが遅れており、4月から9月にかけて実質GDPが2四半期連続のマイナス成長に陥るなど、やや厳しい状況が続いております。海外に目を転じますと、原油価格の急落、中国やアジア新興国の景気の停滞、中東、ロシア等における政治的な緊張感の高まりが、世界経済の下振れリスクとなっております。

当社グループが属しておりますエレクトロニクス業界におきましては、その牽引役をスマートフォンに依存する傾向が強くなっております。また、スマートフォン市場の成長の担い手が中国やインド等の新興国に移っていくに伴い、メーカーシェアの変動や低価格化が進行しつつあります。

このような状況の下、当社グループは、ソニー製の半導体・電子部品事業を軸とし、自社工場におけるEMS（電子機器受託製造サービス）等の高付加価値事業の拡大、取扱い製品の拡張、外部提携も含めた新規事業の創出に引き続き注力してまいりましたが、海外のスマートフォン向け販売の一時的な停滞やタッチパネルメーカーである勝華科技股份有限公司(英文表記Wintek Corporation 以下、Wintek社)の経営破たんに伴い第2四半期に計上した貸倒引当金の影響を受けました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,823億72百万円（前年同期比22.1%減）、営業利益は40億3百万円（前年同期比26.3%減）、経常利益は48億63百万円（前年同期比16.8%減）、四半期純利益は32億27百万円（前年同期比8.6%減）となりました。

セグメント別の業績は次の通りです。

・半導体及び電子部品事業

半導体及び電子部品事業におきましては、主にスマートフォン向け製品の販売が減少したことにより、減収となりました。また、前年の第2四半期に海外連結子会社において計上した貸倒引当金の影響は剥離したものの、減収に加え、Wintek社関連の貸倒引当金の影響により、セグメント利益も減益となりました。

以上の結果、売上高は1,714億0百万円（前年同期比22.6%減）、セグメント利益は42億26百万円（前年同期比23.0%減）となりました。

・電子機器事業

電子機器事業におきましては、景気刺激策等に伴う昨年度の顧客需要増の反動が長期化しており、減収となりました。粗利率の改善や固定費の削減はあったものの、減収の影響が大きく、セグメント損失も拡大しました。

以上の結果、売上高は97億34百万円（前年同期比14.9%減）、セグメント損失は1億67百万円（前年同期は45百万円の損失）となりました。

・システム機器事業

非接触ICカード関連事業におきましては、電子マネー関連ビジネスが引き続き好調に推移し、売上が伸長しました。また、半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス事業におきましては、売上は微減したものの、粗利率が改善しました。

以上の結果、売上高は20億23百万円（前年同期比8.9%増）、セグメント利益は1億49百万円（前年同期比14.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して98億52百万円増加し、1,282億89百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加44億58百万円、商品及製品の増加11億39百万円を主因としたたな卸資産の増加25億27百万円、その他流動資産の増加5億24百万円、投資その他の資産の増加7億1百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比較して58億73百万円増加し、738億84百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加25億46百万円、短期借入金の増加55億61百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少11億13百万円、未払法人税等の減少9億23百万円、その他の流動負債の減少7億6百万円、長期借入金の増加10億88百万円によるものであります。

純資産は前連結会計年度末と比較して39億79百万円増加し、544億5百万円となりました。これは主に四半期純利益32億27百万円、利益剰余金からの配当6億27百万円、為替換算調整勘定の増加11億89百万円、少数株主持分の減少38百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期の第3四半期連結累計期間の業績につきましては、海外のスマートフォン向け販売の一時的な停滞やタッチパネルメーカーのWintek社の経営破たんに伴い第2四半期に計上した貸倒引当金の影響を受けました。第4四半期は海外スマートフォン向け販売の回復が見込まれる一方、タッチパネル事業の仕入先移管等に不確定要素もあるため、現段階では5月9日公表の通期連結業績予想を据え置きます。今後の業績の推移により修正の必要が生じた場合には、速やかに公表いたします。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が71百万円減少し、利益剰余金が45百万円増加しております。なお、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

（会計上の見積りの変更）

（退職給付債務の算定方法の変更）

当社及び一部の国内連結子会社の退職給付制度の統合に伴い、第2四半期連結会計期間より、当社及び一部の国内連結子会社の退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。

この変更に伴い、退職給付債務について計算した簡便法と原則法の差額130百万円を、退職給付費用（販売費及び一般管理費）の減額として計上しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,658	19,303
受取手形及び売掛金	69,633	74,091
商品及び製品	17,611	18,751
仕掛品	434	1,022
原材料及び貯蔵品	370	1,170
その他	5,975	6,499
貸倒引当金	△170	△73
流動資産合計	111,512	120,766
固定資産		
有形固定資産	2,384	2,350
無形固定資産	475	406
投資その他の資産		
投資有価証券	3,011	3,419
その他	2,214	3,157
貸倒引当金	△1,160	△1,809
投資その他の資産合計	4,064	4,766
固定資産合計	6,924	7,523
資産合計	118,436	128,289
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	37,487	40,034
短期借入金	16,120	21,682
1年内返済予定の長期借入金	2,044	930
未払法人税等	1,636	712
賞与引当金	454	213
その他	3,297	2,591
流動負債合計	61,040	66,164
固定負債		
長期借入金	5,893	6,982
退職給付に係る負債	692	353
役員退職慰労引当金	40	34
その他	344	348
固定負債合計	6,970	7,719
負債合計	68,010	73,884

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,383	4,383
資本剰余金	6,342	6,342
利益剰余金	37,818	40,463
自己株式	△2	△3
株主資本合計	48,541	51,186
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	254	390
為替換算調整勘定	1,262	2,451
退職給付に係る調整累計額	△43	4
その他の包括利益累計額合計	1,473	2,846
少数株主持分	410	371
純資産合計	50,425	54,405
負債純資産合計	118,436	128,289

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
売上高	234,143	182,372
売上原価	219,426	169,868
売上総利益	14,717	12,503
販売費及び一般管理費	9,284	8,500
営業利益	5,432	4,003
営業外収益		
受取利息	38	63
受取配当金	33	32
仕入割引	5	5
為替差益	445	864
その他	159	125
営業外収益合計	682	1,092
営業外費用		
支払利息	209	213
売上債権売却損	9	1
その他	48	17
営業外費用合計	267	232
経常利益	5,847	4,863
特別利益		
固定資産売却益	2	0
その他	0	—
特別利益合計	3	0
特別損失		
固定資産処分損	5	3
固定資産売却損	—	1
会員権評価損	17	4
会員権売却損	—	7
その他	0	0
特別損失合計	22	17
税金等調整前四半期純利益	5,828	4,845
法人税等	2,310	1,636
少数株主損益調整前四半期純利益	3,518	3,209
少数株主損失(△)	△13	△18
四半期純利益	3,532	3,227

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,518	3,209
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	18	136
為替換算調整勘定	1,424	1,189
退職給付に係る調整額	—	47
その他の包括利益合計	1,443	1,372
四半期包括利益	4,961	4,582
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,975	4,600
少数株主に係る四半期包括利益	△13	△18

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	半導体及び 電子部品	電子機器	システム機 器	計		
売上高						
外部顧客への売上高	<u>221,582</u>	10,703	1,858	<u>234,143</u>	—	<u>234,143</u>
セグメント間の内部売 上高又は振替高	5	740	—	746	△746	—
計	<u>221,587</u>	11,443	1,858	<u>234,889</u>	△746	<u>234,143</u>
セグメント利益又は損失 (△)	5,488	△45	131	5,573	△141	5,432

(注) 1. セグメント利益の調整額△141百万円には、セグメント間消去取引△2百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△139百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性がないため記載を省略しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	半導体及び 電子部品	電子機器	システム機 器	計		
売上高						
外部顧客への売上高	<u>171,388</u>	8,960	2,023	<u>182,372</u>	—	<u>182,372</u>
セグメント間の内部売 上高又は振替高	12	773	—	785	△785	—
計	<u>171,400</u>	9,734	2,023	<u>183,158</u>	△785	<u>182,372</u>
セグメント利益又は損失 (△)	4,226	△167	149	4,207	△203	4,003

(注) 1. セグメント利益の調整額△203百万円には、セグメント間消去取引△1百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△202百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性がないため記載を省略しております。

(重要な後発事象)

(共通支配下の取引等)

当社は、平成27年2月6日開催の取締役会において、平成27年4月1日付で当社の完全子会社である株式会社UKCエレクトロニクス（以下、「UKCエレクトロニクス」または「分割会社」という）の半導体及び電子部品事業を吸収分割の手法により承継することを決議いたしました。

1. 企業結合の概要

①結合当事企業の名称及び対象となった事業の内容

吸収分割承継会社：株式会社UKCホールディングス（当社）

吸収分割会社：株式会社UKCエレクトロニクス（当社の完全子会社）

事業の内容：半導体及び電子部品事業

②企業結合日

平成27年4月1日（予定）

③企業結合の法的形式

(1)吸収分割の方法

当社を承継会社とし、UKCエレクトロニクスを分割会社とする吸収分割であります。

(2)吸収分割に係る割当ての内容

UKCエレクトロニクスは当社の完全子会社であるため、株式の割当て、その他の金銭等の交付はありません。

(3)その他の吸収分割契約の内容

(イ)吸収分割承継会社が承継する権利義務

当社は、分割会社から本件分割の対象事業を遂行する上で必要とされる当該事業に係る資産・負債及び契約上の地位ならびにこれらに付随する権利・義務を承継いたします。

(ロ)吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会 平成27年2月6日

吸収分割契約書締結日 平成27年2月6日

本吸収分割の効力発生日 平成27年4月1日（予定）

(注) 本会社分割は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易吸収分割であり、分割会社においては会社法第784条第1項に規定する略式組織再編であるため、いずれも株主総会の決議による承認を受けることなく行う予定であります。

④結合後の企業の名称

株式会社UKCホールディングス（当社）

⑤その他取引の概要に関する事項

当社グループは、株式会社ユーエスシーと共信テクノソニック株式会社の共同株式移転により平成21年10月1日に発足して以来、中核事業であるソニー製の半導体・電子部品事業をさらに強化するとともに、EMS（電子機器受託製造サービス）等の高付加価値事業の拡大や新規事業の創出に注力してまいりました。

当社は、持株会社として、経営統合の推進、事業計画の推進、事業の選択と集中、ガバナンス機能の強化等の役割を担ってまいり、所期の目的を概ね達成できたと考えております。

一方、当社グループが属しておりますエレクトロニクス業界、特に半導体・電子部品の領域におきましては、先進国の停滞、中国やインド等の新興国の興隆が顕著で、この目まぐるしく変動する事業環境に対して、迅速かつグローバルな経営判断が求められております。このような背景のもと、今般、意思決定の迅速化、グループ内事業シナジー効果の早期創出、及び更なる経営効率化等を目的として、UKCエレクトロニクスの半導体及び電子部品事業を吸収分割の手法により当社が承継し、事業持株会社として一体的に運営することを決定いたしました。なお、分割会社はシステム機器事業に注力し、国内市場の成長を堅実に取り込んでまいります。

2. 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。